

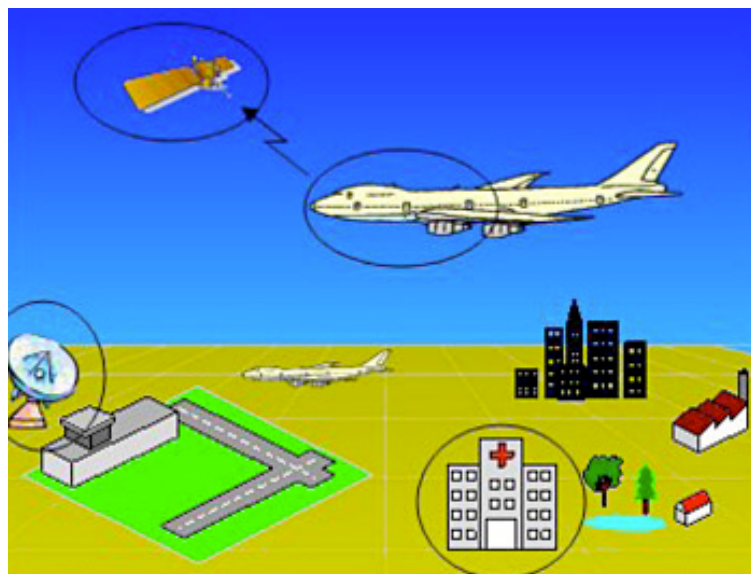
電子・通信機器

同軸・導波管コンポーネントの 規格・技術

同軸・導波管コンポーネントの軽量化を実現するための製造技術「ディップブレイジング」のご紹介および導波管、フランジ規格をご紹介します。



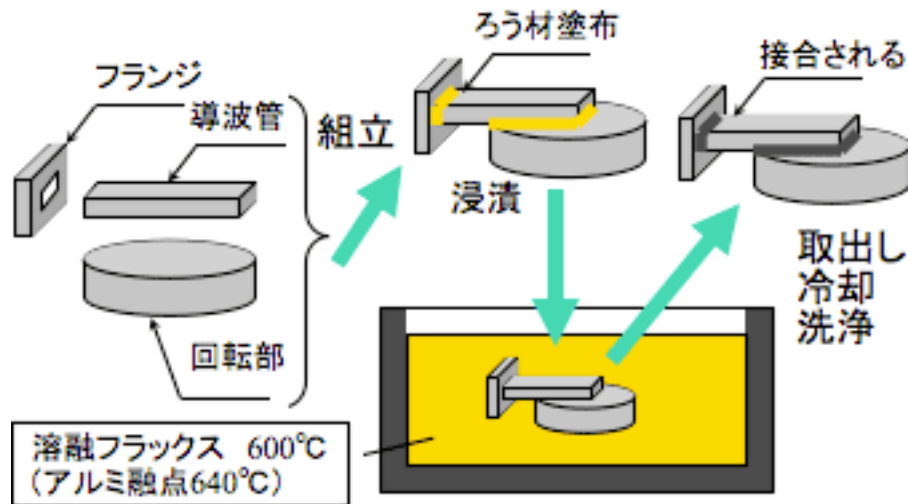
ディップブレイジング技術が使用されている製品



- ・衛星搭載用機器
- ・航空機搭載用機器
- ・航空機管理用レーダー

ディップブレージングとは

加熱したフラックス中に部品を浸漬させ、ろう材を溶かして接合する方法で、金属の溶融温度近くまで加熱できるため通常では出来ないアルミのろう付けが可能です。



ディップブレージング技術の特徴

1. 均一加熱により変形が少なく精密な接合が可能。
2. 複雑な形状のものも容易。
3. 一度に複数の部品を処理可能。

ディップブレージング炉



フラックス炉内温度：600℃

炉内寸法 (WxDxH)：610 x 610 x 1068mm

電極方式：アプトンタイプ黒鉛電極

その他のアルミ接合技術

トーチ型アルミろう付け装置

複数のガスバーナーで同時に加熱、さらに前後に動かし均一に加熱する。火力や加熱時間をプログラミングによりコントロールし、ろう付けを自動で行ないます。

